第4回 大分県先端技術研究会

テーマ：次世代半導体

大分県では、先端技術を持つ研究者・ベンチャー企業と県内企業との交流を通じて、新製品開発や新規事業創出のきっかけを生み出す「先端技術研究会」を開催しています。
今回は「次世代半導体」をテーマに、レーザーを活用した微細加工技術や次世代半導体の開発動向など、半導体製造やものづくりの高度化につながる先端技術をご紹介します。

開催概要

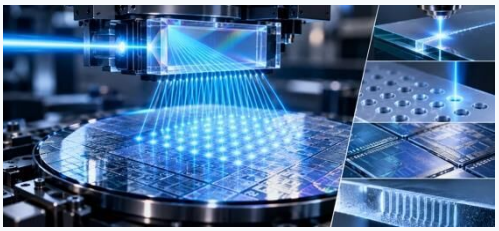
日 時	**2026年11月27日（金）14:00～17:00 （13:45開場）**
会 場	J:COMホルトホール大分 2階 セミナールームS
住 所	大分県大分市金池南1丁目5番1号
対 象	大分県内の製造業、自治体関係者等
主 催	大分県
運 営	株式会社リバネス

計算機ホログラムを用いたビーム成形レーザー加工機の作り方と使い方

講師：株式会社ホロデザイン 取締役／宇都宮大学 卓越教授 早崎 芳夫 氏

技術の特徴

- ホログラフィ技術でレーザーを「面」に拡張し、**加工速度を最大100倍、加工精度を最大10倍に向上可能。**
- ガラス・半導体材料の穴あけ／切断、レーザーマーキング、金属溶接、表面テクスチャリング、透明材料内部の微細加工などに対応。
- **既存のレーザー加工機に後付け可能。**



※レーザー微細加工のイメージ図

酸化ガリウムパワー半導体の進展とその先へ

株式会社ヘテロスタックス 代表取締役 佐々木 公平 氏

講演内容

酸化ガリウム（Ga_2O_3）は、次世代の高耐圧・低損失パワー半導体材料として期待されている。6インチウエハや超高耐圧トランジスタの進展や、SiCや酸化ガリウム等の**単一材料デバイスの限界を超える、異種接合型デバイスという新しいコンセプトについても紹介する。**



※イメージ図

こんな方におすすめ

- ✓ 次世代半導体、半導体関連技術や製造工程の高度化に関心がある方
- ✓ レーザー加工・精密加工・新しい製造技術を探している方
- ✓ 自社の製造技術と先端技術を組み合わせたい方
- ✓ 研究者やベンチャー企業との共同開発を検討している方

お申し込み

参加をご希望の方は、以下の申込フォーム、QRコードよりお申し込みください。

https://forms.gle/SvAENrLXNxhAY9dh7

参加申込

お問い合わせ 株式会社リバネス 地域開発事業部 TEL：03-5227-4198 E-mail：ld@lnest.jp